

Title (en)

Connection device and method for producing an electrically conducting connection

Title (de)

Verbindungsvorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung

Title (fr)

Dispositif de connexion et procédé de fabrication d'une connexion électrique conductrice

Publication

**EP 2453526 A1 20120516 (DE)**

Application

**EP 11189051 A 20111114**

Priority

DE 102010051069 A 20101112

Abstract (en)

The device has a contact element (13) arranged in housing (11) that is formed as housing lower part and housing cover. The contact element includes a connection link for a crimping connection for fixing a cable and another connection link for the crimping connection for forming an electrically conducting connection with a conductor. The contact element includes a contact pin for forming the electrically conducting connection with a terminal of a printed circuit board (15), where the contact pin is provided with an express zone and soldering lug. An independent claim is also included for a method for fastening cable to a printed circuit board and for manufacturing an electrically conducting connection between a conductor of the cable and a terminal of the printed circuit board.

Abstract (de)

Es wird eine Verbindungsvorrichtung zur Befestigung mindestens einer Leitung (17) auf einer Leiterplatte (15) und zur Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen einem Leiter (16) der Leitung (17) und mindestens einem entsprechenden Anschluss (35) der Leiterplatte (15) beschrieben, wobei die Verbindungsvorrichtung ein Gehäuse (11, 41, 42) aufweist. Zur Herstellung einer mechanisch und elektrisch sicheren Verbindung zwischen Leitung und Leiterplatte ist in dem Gehäuse (11, 41, 42) mindestens ein Kontaktelement (13, 43) angeordnet, wobei das Kontaktelement (13, 43) jeweils erste Mittel (31, 53) zur Festlegung der Leitung (17), zweite Mittel (33, 53) zur Ausbildung einer elektrisch leitenden Verbindung mit dem Leiter (16) und dritte Mittel (25, 39, 49) zur Ausbildung einer elektrisch leitenden Verbindung mit mindestens einem entsprechenden Anschluss (35) der Leiterplatte (15) aufweist.

IPC 8 full level

**H01R 4/18** (2006.01); **H01R 12/58** (2011.01)

CPC (source: EP US)

**H01R 4/184** (2013.01 - EP); **H01R 4/2433** (2013.01 - EP); **H01R 4/2454** (2013.01 - EP US); **H01R 12/585** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [XA] DE 202010011546 U1 20101104 - ERNI ELECTRONICS GMBH [DE]
- [X] US 5910031 A 19990608 - GOTO KAZUHIRO [CA]
- [X] WO 2010063459 A1 20100610 - WUERTH ELEKTRONIK ICS GMBH & C [DE], et al

Cited by

CN110870140A; EP3428004A1; CN107592948A; US2021391659A1; US10158185B2; US10069223B2; WO2016178861A1; WO2015191549A1; EP3811468B1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 2453526 A1 20120516**; DE 102010051069 A1 20120516

DOCDB simple family (application)

**EP 11189051 A 20111114**; DE 102010051069 A 20101112